

証券コード：6599

EBRAIN エブレン株式会社



EBRAIN

2021年3月期 第3四半期
会社説明資料

- 会社概要
- 事業内容の説明

事業内容、

ボードコンピュータ、バックプレーン、コンピューターシャーシ、
制御用コンピュータ、バックプレーン方式が産業用に多用される理由、
コンピューターBUSの標準規格、
エブレン製品の応用分野、主要納入先、生産拠点の分散、

- 第3四半期の業績

2021年3月期第3四半期 概況

2021年3月期第3四半期 実績・通期予想、

2021年3月期第3四半期 応用分野別売上

2021年3月期第3四半期 業績・財政状態

2021年3月期第3四半期概況、

- 成長への取り組み

設 立	1973年 (昭和48年) 10月
本 社	東京都八王子市石川町
資 本 金	1億4,301万円
売 上 高	31億83百万円 (2020年3月期)
経 常 利 益	3億3百万円 (同上)
従 業 員 数 〔ほか、平均臨時雇用人員〕	117名〔16名〕
事 業 所	東京都八王子市、東京都荒川区、埼玉県入間市、大阪市東淀川区
子 会 社	蘇州エブレン (蘇州惠普聯電子有限公司：中国江蘇省蘇州市)
事 業 内 容	産業用電子機器・工業用コンピュータの設計製造販売

- 現在のメインの仕事内容は、
通信・電力・鉄道・医療などの「**社会インフラ系設備**」および半導体製造装置や生産自動化機械などの「**産業インフラ系設備**」に、
コントローラーとして使用される産業用コンピュータの**受託設計**と**受託生産**が中心で、売上の80%を占めています。
- 鉄道・電力・通信などの公共性の高い事業会社向け設備の開発や調達は、**大手のメーカーが主契約者**となっていて、私どものビジネスのポジションとしては、その下になります。
- 主契約者のメーカーは、設備やシステムの開発構想に基づいて、
当社へ委託するコンピュータ製品の「**要求仕様書**」を作成して提示し、私共はその「**要求仕様**」に基づいて**製品を設計**し、試作品を作ってメーカーへ送り、評価と設計検証を受けます。
- 量産に入る迄に半年とか一年以上の期間を要する事もありますが、**量産開始以降は中長期的に安定した製品供給**を要求されます。

通信・放送



鉄道



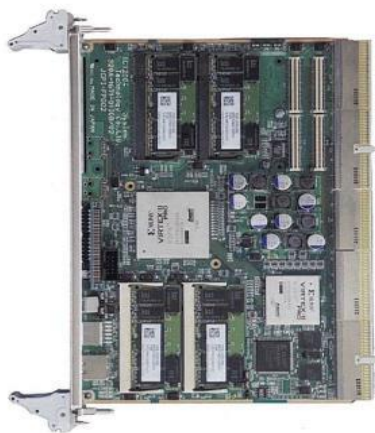
医療



半導体製造装置



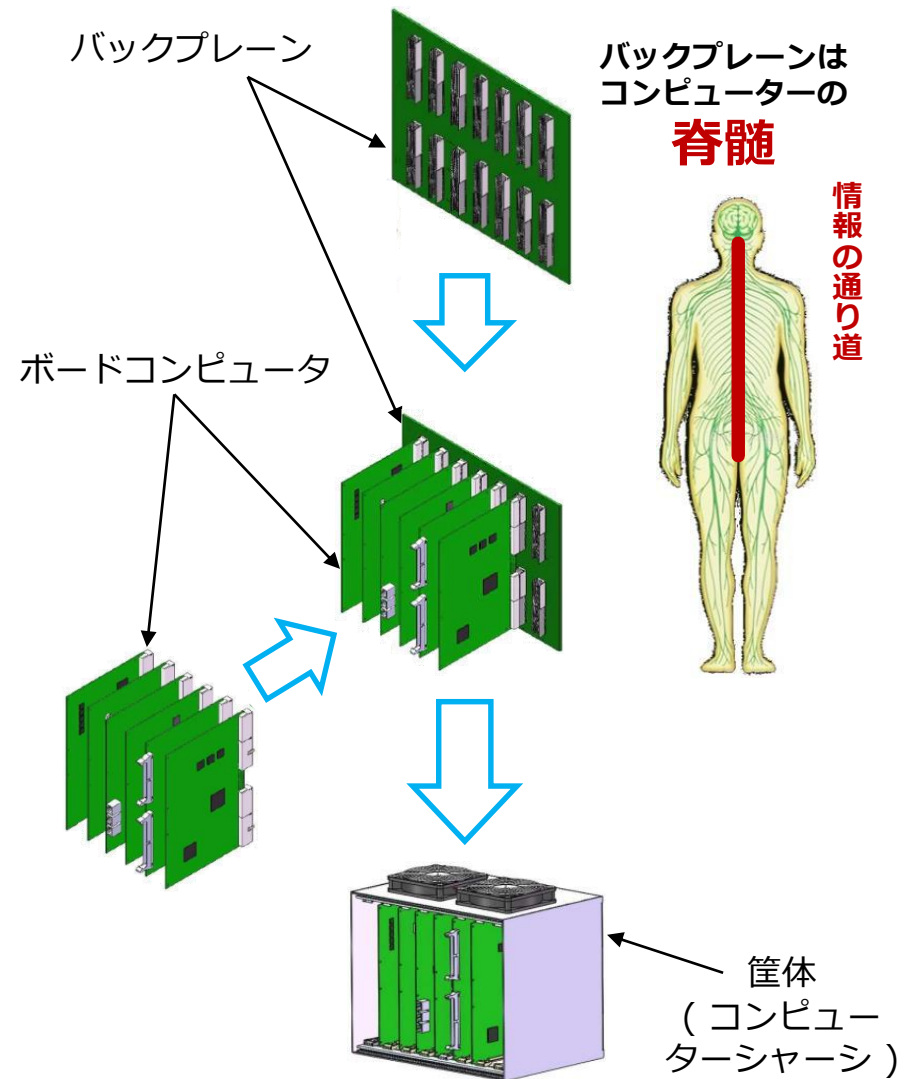
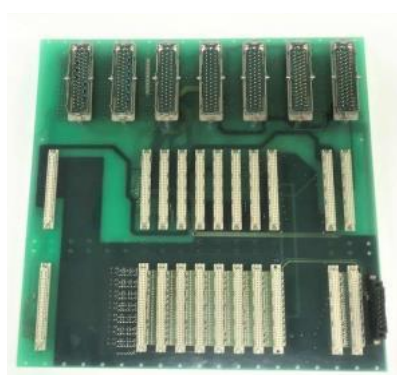
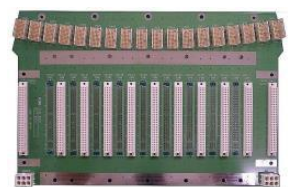
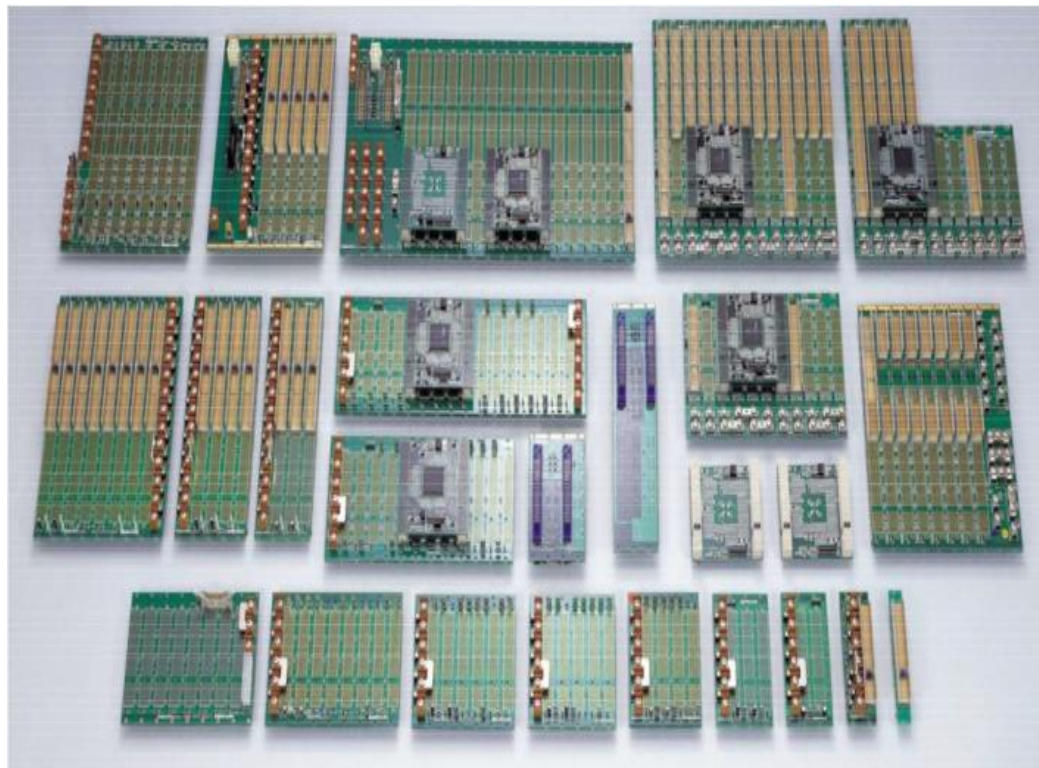
- バックプレーンシステム用
ボードコンピュータ



- IoT・Edge システム用
ワンボードコンピュータ



製品区分(2) バックプレーン



CompactPCI®

CompactPCI® Express

AdvancedTCA®

CompactPCI® Serial

μTCA®

COM  **Express®**



Open Modular
Computing Specifications



PCI  **EXPRESS®**

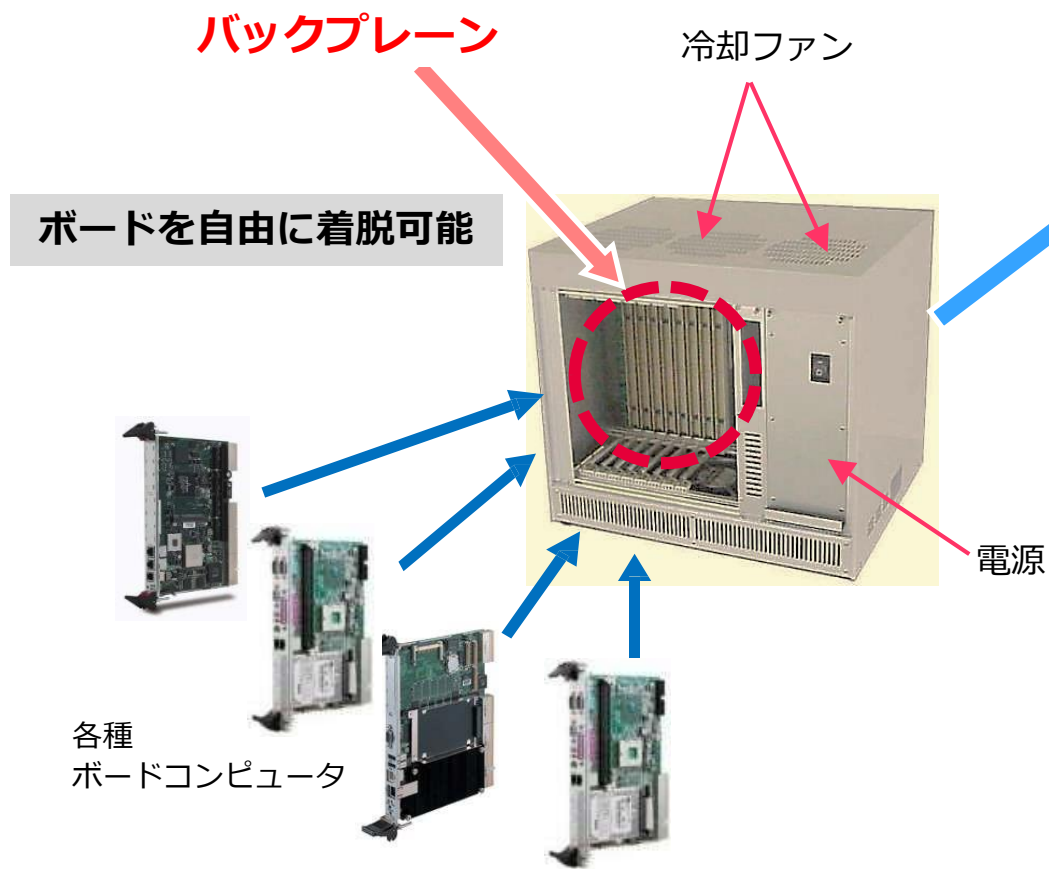
- バスラック
(バックプレーン搭載型シャーシ)



- ワンボード型シャーシ
(IoT・Edgeシステム用)



製品区分(4) 制御用コンピュータ



(例・半導体製造装置)

【バックプレーン方式の利点】

ボードコンピュータが自在に着脱可能

1.保守性

ホットスワップ、
保守体制、保守要員、

2.拡張性

拡張スロット、増設、

3.汎用性

市場に流通しているボードコンピュー
タを採用する事が可能。

多くの産業用コンピューターで
バックプレーン方式が採用される

バックプレーン

【役割】
各種回路基板を相
互に接続して
信号伝送や電力供
給を行う

冷却ファン

筐体

ガイドレール

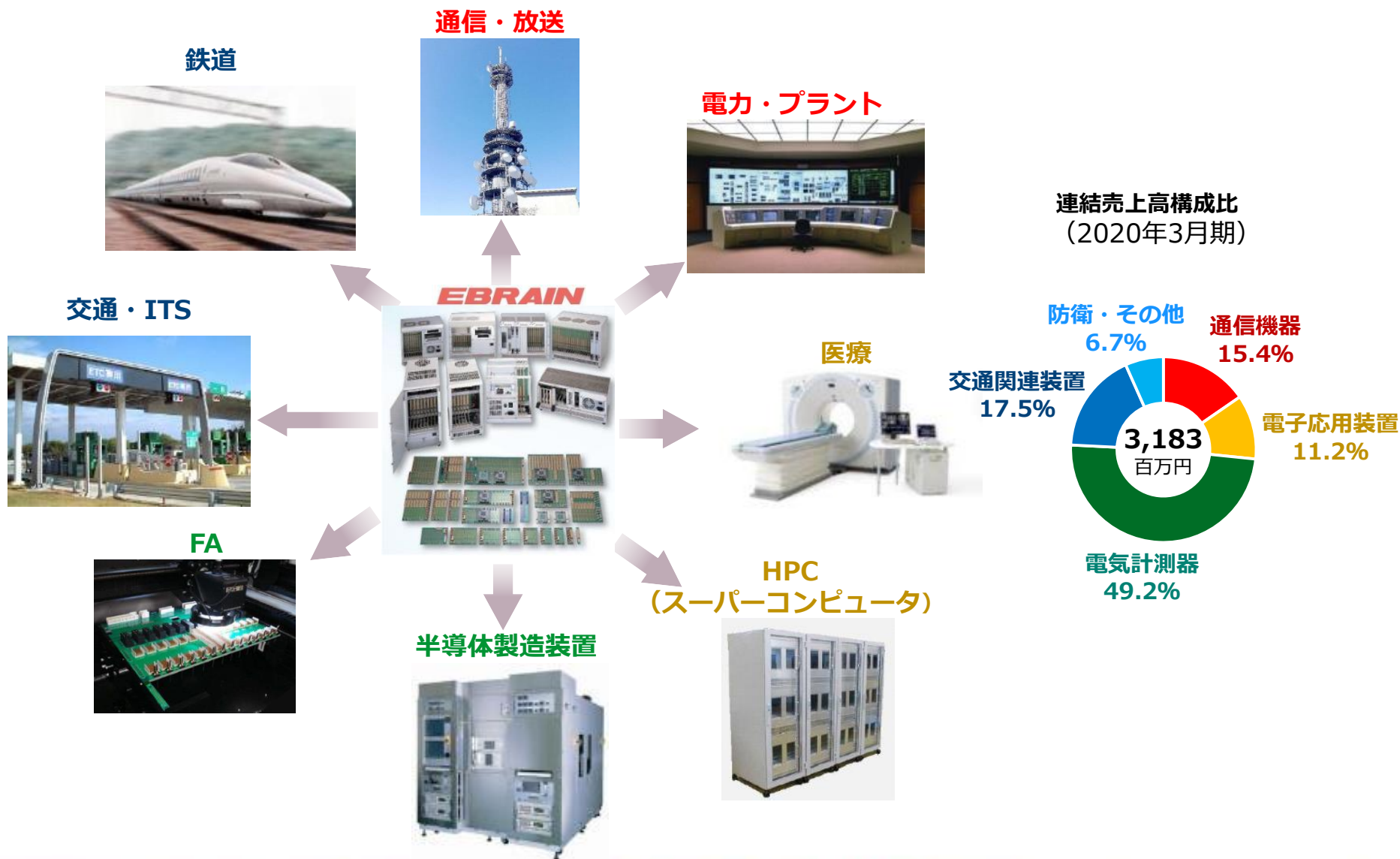
電源



ボードコンピュータ

エブレン製品の用途（応用分野）

産業インフラ・社会インフラ関連の大手企業と安定的な取引関係を継続



主要納入先 (直接納入,間接納入を含む)

各分野の主要メーカーへ納入

NEC

NEC グループ各社

HITACHI
Inspire the Next

日立製作所
グループ各社

FUJITSU

富士通グループ各社

住友電工
Connect with Innovation

住友電気工業 (株)

GE Healthcare

GE Healthcare
グループ各社

Preferred Networks

(株) プリファード・
ネットワークス

三菱重工

三菱重工
グループ各社

MITSUBISHI ELECTRIC

三菱電機
グループ各社

Kawasaki

川崎重工業
グループ各社

TEL

東京エレクトロン
グループ各社

Canon

キヤノンメディカル
システムズ (株)

古河電工

古河電気工業 (株)

KYOSAN

(株) 京三製作所

viswill

第一実業ビスウィル (株)

Panasonic

パナソニック
グループ各社

TOSHIBA

東芝 グループ各社

Lasertec

レーザーテック (株)

OLYMPUS

オリンパスメディカル
システムズ (株)

Nikon

(株) ニコン

SCREEN

(株) SCREENセミコンダクター
ソリューションズ

日本信号株式会社

日本信号 (株)

SONY

ソニーグローバル
マニュファクチャリング&
オペレーションズ

MEIDEN

(株) 明電舎

TOKYO KEIKI

東京計器 (株)

Anritsu

アンリツ (株)

SAMSUNG

サムスン電子
グループ各社

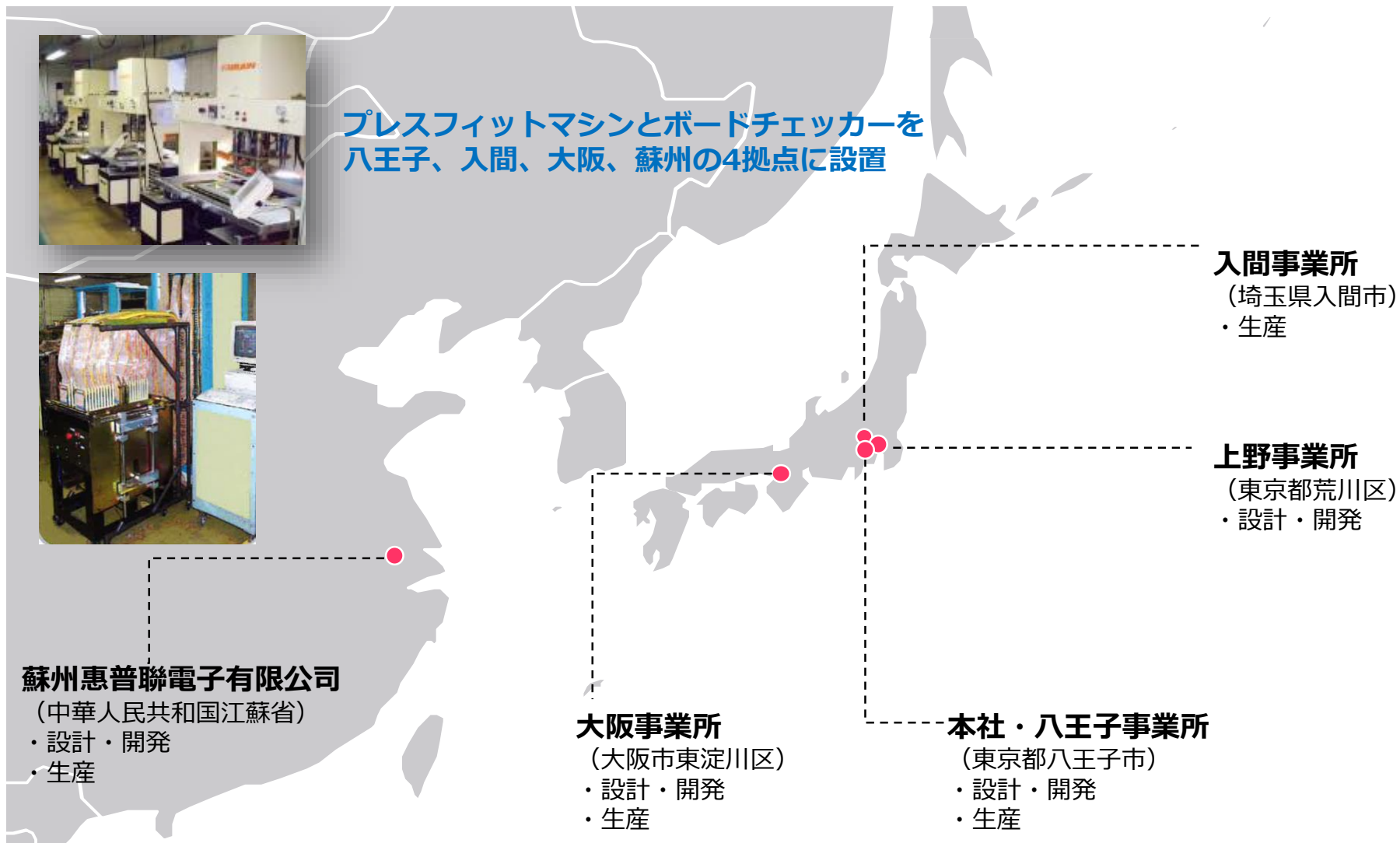
USHIO

ウシオ電機 (株)

ONO SOKKI

(株) 小野測器

BCPの観点から生産拠点を分散



証券コード：6599

EBRAIN エブレン株式会社



第3四半期 業績報告

業種により差があるが、全体では概ね予算通り

- ✓ 通期予想は年初の計画から変更なし
- ✓ 半導体製造装置関連が好調
 - ✓ 台湾のファウンドリーで生産調整が発生したが、現在は回復傾向
- ✓ 鉄道関連が好調
 - ✓ 一部の鉄道・信号関連メーカーで特需が発生
- ✓ 新型コロナウイルスの影響で放送・通信・医療関係が低調
 - ✓ 設置工事ができず、入札延期
 - ✓ 病院の収益悪化による投資先送り

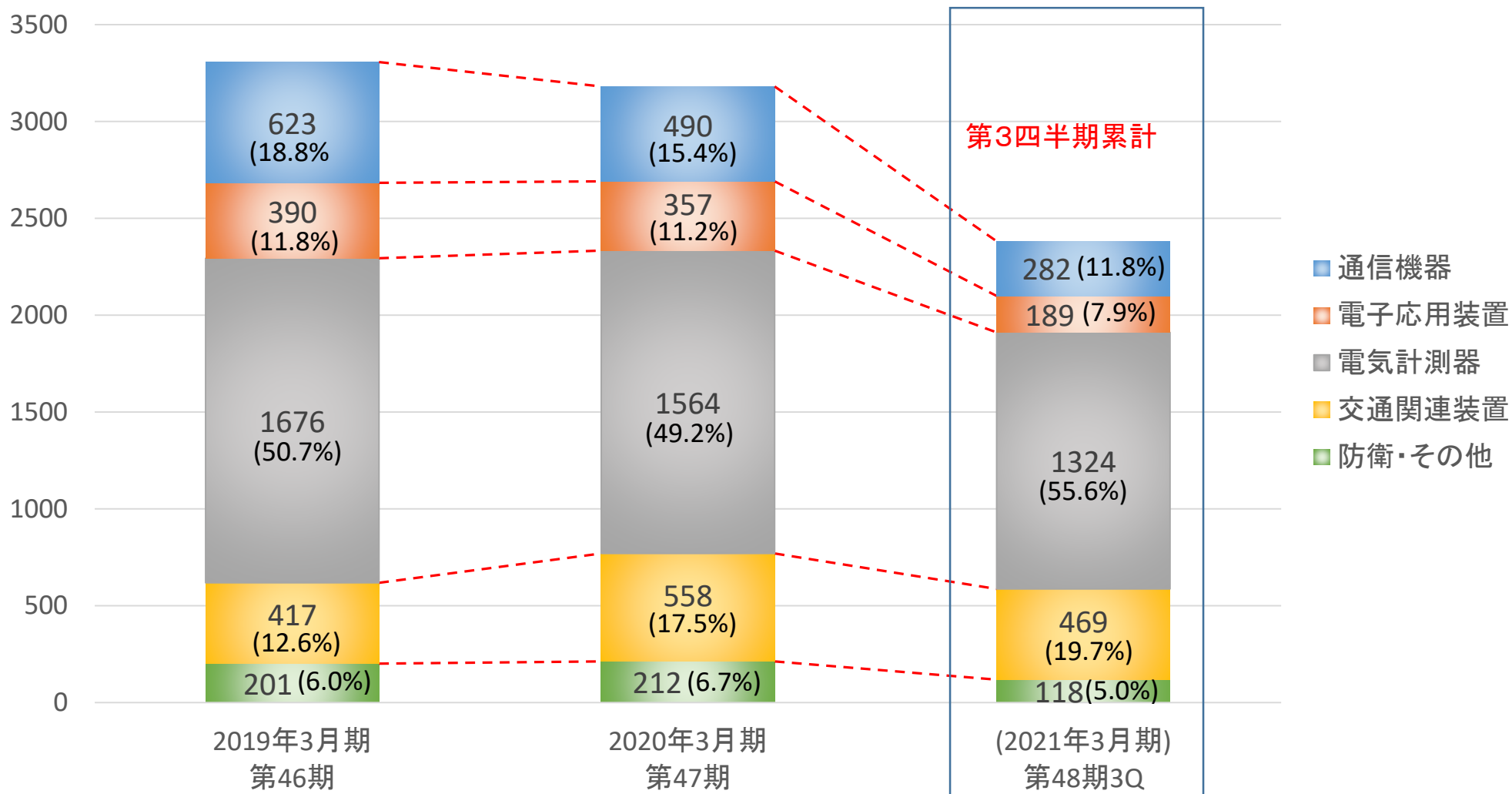
連結損益計算書

単位：百万円(百万円未満四捨五入)

	2019.12 (百万円)	2020.12 (百万円)	前年同期 増減率 ^(注)	通期予想	通期計画 進捗率
売上高	2,412	2,385	-1.1%	3,374	70.7%
営業利益	222	216	-2.7%	337	64.1%
営業利益率	9.2%	9.1%		10.0%	
経常利益	241	218	-9.5%	314	69.4%
経常利益率	10.0%	9.1%		9.3%	
当期純利益	160	149	-6.9%	207	72.0%
当期純利益率	6.6%	6.2%		6.1%	

連結応用分野別売上推移

単位：百万円(百万円未満四捨五入)



連結貸借対照表

	2020.3 (百万円)	2020.12 (百万円)	前期末比
流動資産	2,938	3,231	+9.9%
固定資産	1,259	1,271	+0.9%
資産合計	4,197	4,502	+7.2%
流動負債	726	737	+1.5%
固定負債	383	371	▲3.1%
負債合計	1,110	1,109	▲0.0%
純資産	3,087	3,393	+9.9%
負債純資産合計	4,197	4,502	+7.2%
自己資本比率	73.5%	75.3%	

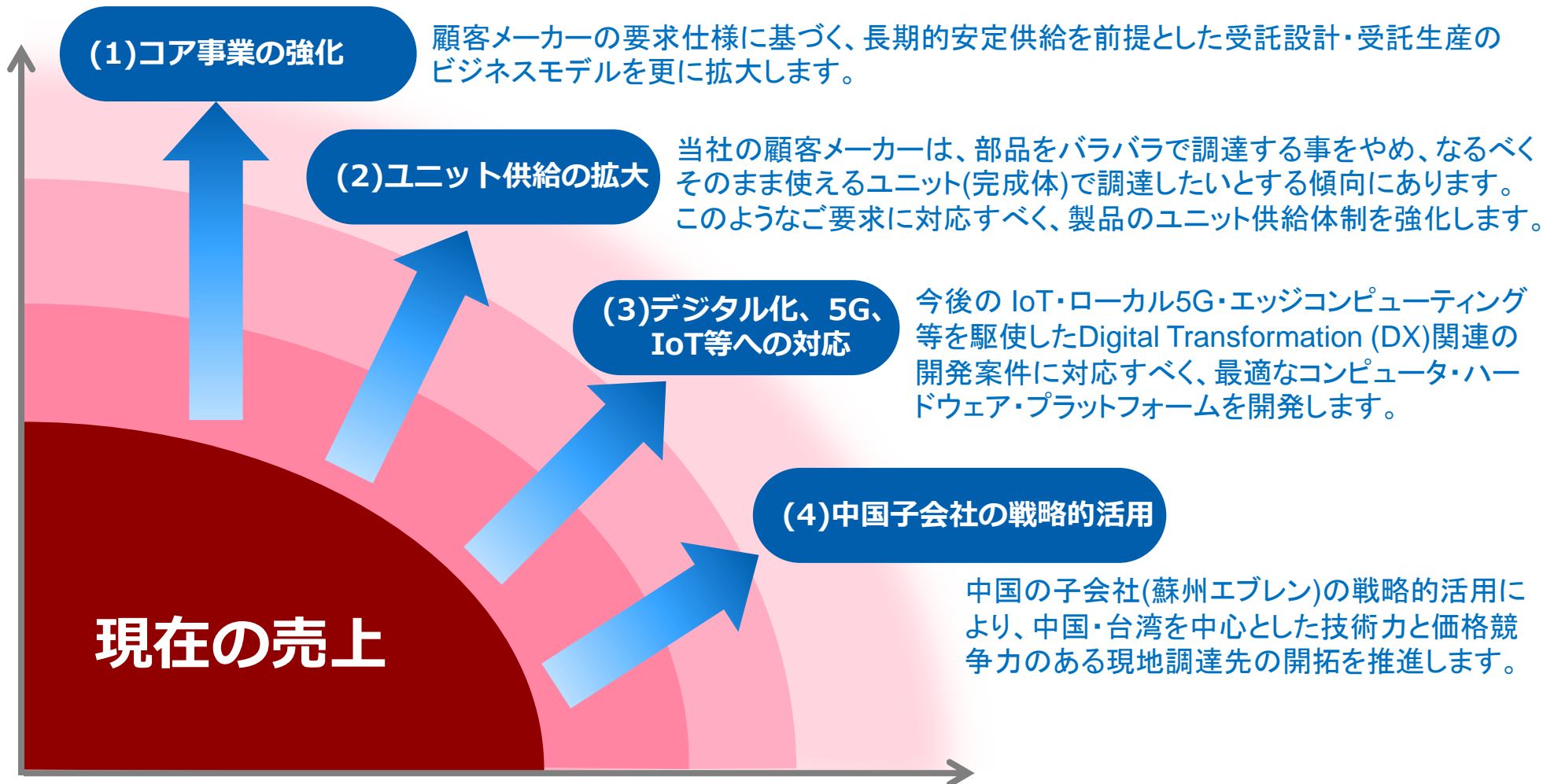
証券コード：6599

EBRAIN エブレン株式会社



成長への取り組み

より価値のあるソリューションの提供を通して企業価値の拡大を目指す



(1) コア事業の強化

顧客メーカーの要求仕様に基づく 受託設計・受託生産・長期的安定供給のビジネスモデルを更に拡大します。

大手システムメーカーの動向

過去

大手メーカーは設計・部材調達・生産など全てのプロセスを自社で完結していたが……

製品開発期間短縮の必要性の高まり

慢性的な技術リソース不足

技術の高度化・開発費の増大

今後

「選択と集中」が進み、ノウハウのある専門メーカーとの協業が拡大する

専門メーカーとしての
優位性を追求
(短納期・低コスト・品質向上)



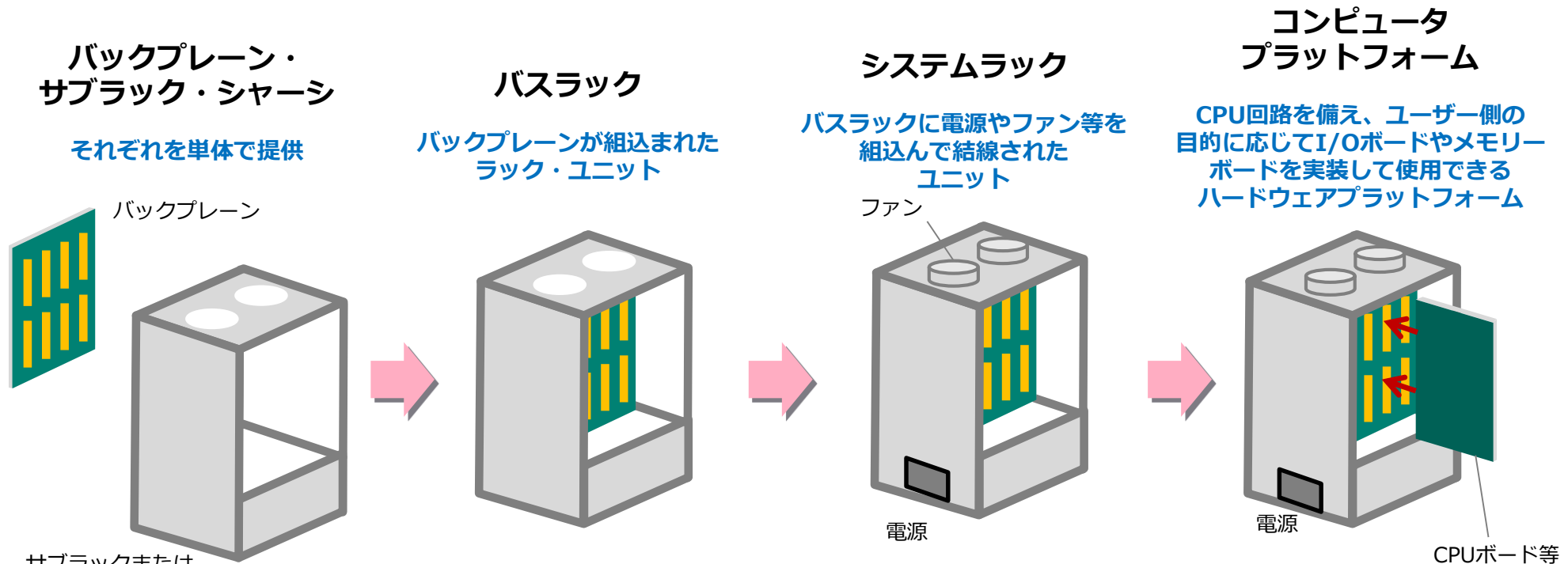
コンピューターバス テクノロジーの深耕
コンピューター構造技術/生産技術の深耕
(冷却構造、耐電磁波構造 等)

システムパーツ・共通部材の拡充
(FANアラームボード、標準部材 等)

(2) ユニット供給の拡大

当社の顧客メーカーは、部品をバラバラで調達する事をやめ、なるべくそのまま使えるユニット(完成体)で調達したいとする傾向にあります。

このようなご要求に対応すべく、製品のユニット供給体制を強化します。



年々構成レベルの高い(完成品に近い)製品に対する需要が増加する傾向

お客様が本来の研究開発活動にリソースを集中していただけるよう、
お客様の多様なニーズに応えられる体制を拡充

(3) デジタル化 (DX) への対応

今後の IoT・ローカル5G・エッジコンピューティング等を駆使したDigital Transformation (DX)関連の開発案件に対応すべく、最適なコンピュータ・ハードウェア・プラットフォームを開発します。

デジタル社会を取り巻く動き

今後のデジタル化に関する様々なテーマが目白押し

クラウド/
ビッグデータ

5G/
Local 5G

Edge
Computing

AI

スパコン/
HPC

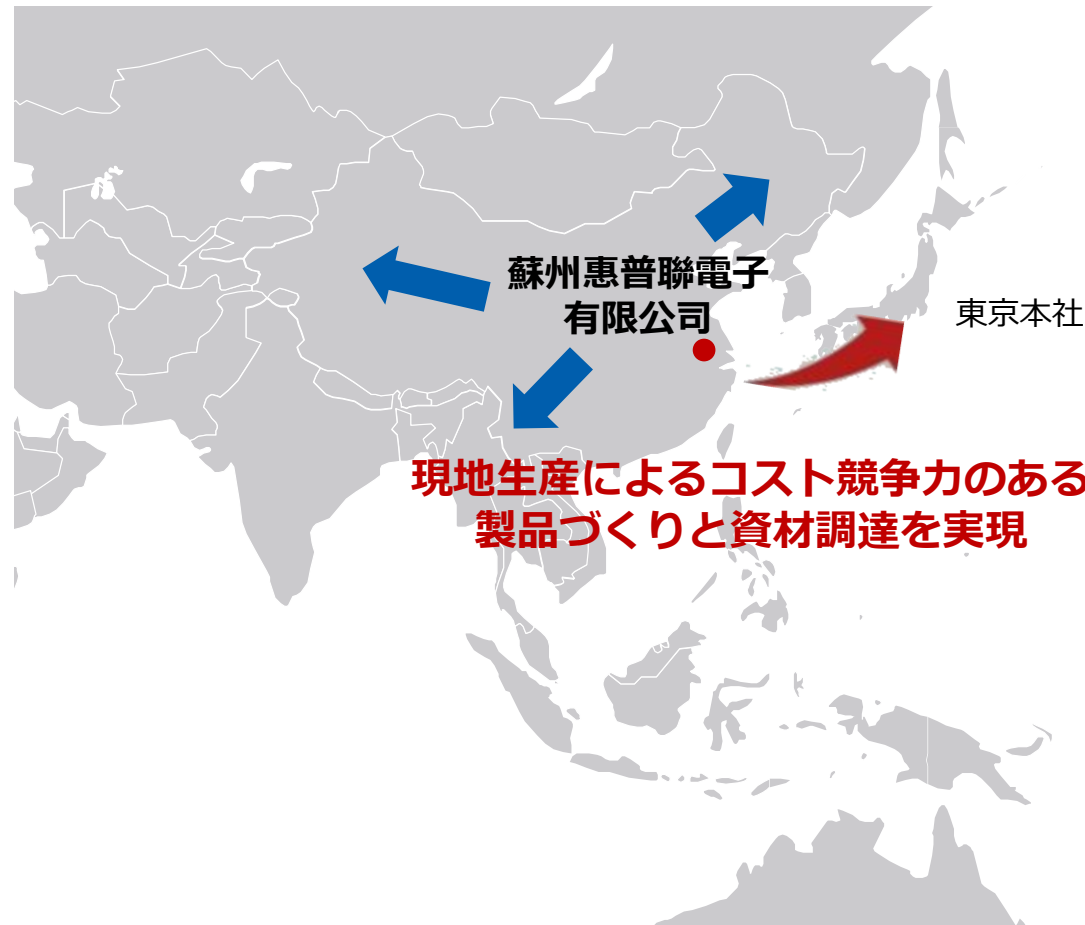
IoT

これらの分野にはすべて
それぞれの目的に叶ったコンピューターが不可欠

ユーザーの要求を満たす最適なコンピュータープラットフォームを提供

(4) 中国子会社の活用強化

中国の子会社(蘇州エブレン)の戦略的活用により、中国・台湾を中心とした技術力と価格競争力のある現地の部材調達先の開拓を推進します。現地企業および日系の進出企業へ現地生産によるコスト競争力のある製品を提供します。



蘇州惠普聯電子有限公司
概要

会社名	蘇州惠普聯電子有限公司
本社所在地	中華人民共和国江蘇省蘇州市
創業開始	2002年9月
資本金	82百万円
株主構成	当社100%
事業内容	バックプレーン及びバスラック等の製造販売及び輸出入、部材の現地生産調達先の開拓

本資料に掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、確信等は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因にかかわる仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって予測数値とは異なる可能性があるため、本資料のみに全面的に依拠することは控えていただきますようお願い申し上げます。

また、本資料は投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、ご自身のご判断において行われますようお願い申し上げます。

ご清聴ありがとうございました。

EBRAIN